

2025年半導體科技暑期三日營

今年暑假，別讓孩子錯過未來科技的門票！

由工研院專家親自授課，帶領高中生深入探索半導體材料、3D列印技術、AI模擬應用等尖端科技，三天掌握未來半導體產業核心知識！

課程特色

- 實作導向 × 實驗室體驗 × 啟發式學習！
- 直擊未來科技脈動，強化學習歷程檔案，升學面試加分！
- 小班制教學，與專家面對面互動，提升學習深度！

梯次/日期

第一梯7/2~7/4、第二梯7/9~7/11、第三梯8/27~8/29。

上課地點

台南市歸仁區高發二路360號（沙崙綠能科技示範場域）E203教室

報名 / 費用

即日起至6/20，額滿截止。 7,500元/人（含中餐）。

Day	時間	課程	單元重點	講師
<u>Day1</u> 7/2 7/9 8/27	09:00-12:00	半導體材料發展	• 從陶瓷材料概論到半導體材料特性與發展，深入淺出介紹半導體材料產業發展趨勢。 • 搭配本實驗室合成的碳化矽粉體材料做解說。	工研院材化所 邱國創組長
	13:00-16:00	3 D列印技術與應用	• 陶瓷材料加工技術在半導體產業的應用，以及加工技術發展與其加工原理。 • 簡介3D列印技術、列印原理及其應用案例。	工研院材化所 葉奎佑/ 何朝仁經理
<u>Day2</u> 7/3 7/10 8/28	09:00-12:00	半導體製程與長晶技術發展	• 半導體製程簡介，從晶圓製造的前端製程到後端製程的基本概念介紹。 • 簡介各種半導體晶圓成長技術與應用。	工研院材化所 吳禹函副組長 劉子瑜副組長
	13:00-16:00	化合物半導體長晶技術與參觀	• 介紹下世代化合物半導體長晶技術。 • 參觀工研院材化所於台南沙崙的化合物半導體材料驗證實驗室。	工研院材化所 高宥榛經理/ 翁雪萍
<u>Day3</u> 7/4 7/11 8/29	09:00-12:00	AI介紹與其應用	• 介紹AI技術發展及技術架構，與AI應用發展趨勢。 • 以AI影像辨識技術進行案例說明。	工研院材化所 劉子瑜副組長 詹皓宇
	13:00-16:00	AI模擬技術應用	應用AI模擬技術輔助材料研發，並以案例說明。	工研院材化所 邱國創組長

備註: 主辦單位保留課程內容變更之權利。

2025年半導體科技暑期三日營

課程重點

1. 半導體材料發展、3 D列印技術與應用。
2. 半導體長晶技術發展。
3. AI模擬技術應用於材料基本特性、製備方法的應用。

報名方式(二擇一)

1. 填寫以下報名資料，email電子檔到yfwu@itri.org.tw
2. 掃描下方QR code線上報名。

注意事項

1. 報名後請於6/20完成繳費(7,500元)，並email to：yfwu@itri.org.tw
告知：繳費日期、繳費金額與帳號後5碼。
2. 上課通知會以email發送，請務必填寫正確的email信箱與手機號碼。
3. 課程聯絡專線：06-3636986工研院吳小姐。

繳費帳號

銀行名稱：土地銀行工研院分行
戶名：財團法人工業技術研究院
帳號(A/C NO)：156-005-00002-5

[2025年半導體科技暑期三日營報名表]

學校：_____ 班級：_____ 姓名：_____

(保險所需)身份證字號：_____ 出生年月日：_____

報名梯次(勾選)：☐ 第一梯7/2~7/4
☐ 第二梯7/9~7/11
☐ 第三梯8/27~8/29

手機：_____ Email: _____



線上報名QR Code